



Fig.	Type d'appareil	Dimensions - pouces (mm)							N° de référence Digi-Key	Prix unitaire				N° de référence Bergquist
		A	B	C	D	E	F	G		1	10	50	100	
8	CPU	.63 (16.00)	.63 (16.00)	—	—	—	—	—	BER133-ND	.44	.40	.36	.32	CPU 63X.63
		1.375 (34.93)	1.375 (34.93)	—	—	—	—	—	BER135-ND	.73	.66	.59	.52	CPU 1.375X1.375
	Pont redresseur	1.00 (25.40)	1.00 (25.40)	.187 (4.75)	—	—	—	—	BER142-ND	.39	.35	.32	.28	Q3-48
		1.25 (31.75)	1.25 (31.75)	.200 (5.08)	—	—	—	—	BER144-ND	.42	.37	.34	.30	Q3-46
9	Tubes TO-220	.433 (11.00)	.985 (25.02)	—	—	—	—	BER145-ND	1.22	1.09	.98	.87	K10-46	
	Tubes TO-247	.532 (13.50)	.985 (25.02)	—	—	—	—	BER156-ND	.62	.56	.50	.44	SPT400-12-11-25	
10	TO-5	.360 (9.14)	.200 (5.08)	.040 (1.02)	—	—	—	BER157-ND	.75	.68	.61	.54	SPT400-12-13.5-25	
Pastilles « Hi-Flow™ » à support adhésif simple face (à changement de phase)														
1	TO-3	1.65 (41.91)	1.14 (28.96)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER161-ND	.24	.21	.19	.17	HF115TAAAC-05
3	TO-220	.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER167-ND	.09	.08	.07	.06	HF115TAAAC-54
3	TO-220	.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER168-ND	.09	.08	.07	.06	HF115TAAAC-58
3	TO-218	.860 (21.84)	.740 (18.80)	.200 (5.08)	.160 (4.06)	—	—	—	BER169-ND	.10	.09	.08	.07	HF115TAAAC-90
5	SIP	1.450 (36.83)	.830 (21.08)	.612 (15.54)	.245 (6.22)	.960 (24.38)	.170 (4.32)	.120 (3.05)	BER170-ND	.12	.11	.10	.09	HF115TAAAC-105
Pastilles « SP900 » à support adhésif simple face (à faible pression de montage)														
1	TO-3	1.65 (41.91)	1.14 (28.96)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER181-ND	.97	.87	.78	.69	SP900EAAC-05
3	TO-220	.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER182-ND	.63	.57	.51	.45	SP900EAAC-54
3	TO-220	.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER183-ND	.63	.57	.51	.45	SP900EAAC-58
Bande thermique double face « Bond Ply™ 100 »														
Pastille thermique adhésive double face, 0,005" (0,127 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 11" x 12" (27,94 x 30,48 cm)									BER246-ND	35.10	31.32	28.08	24.84	BOND PLY 105 11x12"
Pastille thermique adhésive double face, 0,008" (0,203 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 10" (25,4 cm)									BER159-ND	43.19	38.54	34.56	30.57	BOND PLY 108 10x10"
Pastille thermique adhésive double face, 0,011" (0,279 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 10" (25,4 cm)									BER160-ND	54.01	48.20	43.21	38.23	BOND PLY 111 10x10"
Matériau de remplissage thermique « Gap Pad™ 1500 »														
Pastille à haute conductivité thermique, 0,020" (0,508 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 4" (10,16 cm)									BER161-ND	8.45	7.55	6.77	5.99	.020 GP 1500 4" X 4"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,040" (1,02 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 4" (10,16 cm)									BER162-ND	12.14	10.84	9.72	8.60	.040 GP 1500 4" X 4"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,060" (1,52 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 4" (10,16 cm)									BER163-ND	13.93	12.43	11.15	9.86	.060 GP 1500 4" X 4"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,080" (2,03 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 4" (10,16 cm)									BER164-ND	16.47	14.69	13.17	11.65	.080 GP 1500 4" X 4"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,125" (3,18 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 4" (10,16 cm)									BER165-ND	22.35	19.95	17.89	15.82	.125 GP 1500 4" X 4"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,040" (1,02 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER227-ND	83.88	74.85	67.11	59.36	.040 GP 1500 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,060" (1,52 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER228-ND	82.03	73.20	65.63	58.06	.060 GP 1500 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,080" (2,03 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER229-ND	93.95	83.84	75.17	66.49	.080 GP 1500 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,125" (3,18 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER230-ND	160.35	143.08	128.28	113.48	.125 GP 1500 8" X 16"
Matériau de remplissage thermique « Gap Pad™ 1500R »														
Pastille à haute conductivité thermique, 0,010" (0,254 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER231-ND	45.92	40.98	36.74	32.50	GP1500R 10 MIL 8" x 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,015" (0,381 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER232-ND	56.24	50.19	45.00	39.80	GP1500R 15 MIL 8" x 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,020" (0,508 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER233-ND	61.80	55.15	49.44	43.74	GP1500R 20 MIL 8" x 16"
Matériau de remplissage thermique « Gap Pad™ VO Ultra doux »														
Pastille à haute conductivité thermique, 0,020" (0,508 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER222-ND	61.03	54.46	48.83	43.19	.020 GP US 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,040" (1,02 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER223-ND	76.75	68.49	61.40	54.32	.040 GP US 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,060" (1,52 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER224-ND	86.11	76.84	68.89	60.94	.060 GP US 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,080" (2,03 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER225-ND	98.66	88.04	78.93	69.82	.080 GP US 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,125" (3,18 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER226-ND	163.79	146.15	131.04	115.92	.125 GP US 8" X 16"

* En matériau SP400

C

KEYSTONE

Isolateurs en MICA pour montage de transistor

Ces isolateurs en MICA estampés avec précision assurent une bonne conductivité thermique (0,009 Watts par pouce carré par °C par pouce d'épaisseur). Excellente résistance thermique 1 100 °F (593 °C). Constante diélectrique de 7 à 1 000 kHz.

Spécifications : MICA de 0,003" (0,08 mm) d'épaisseur ± 0,001" (± 0,03 mm).

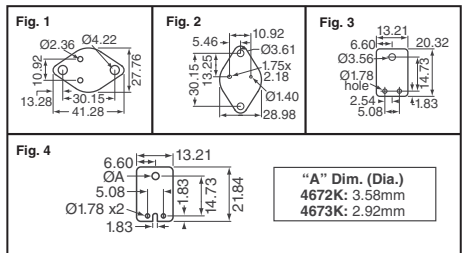
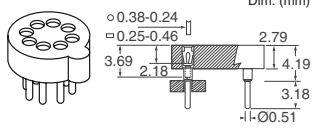


Fig.	N° de référence Digi-Key	10	100	Prix 500	1 000	N° de référence Keystone
1	4651K-ND	1.09	9.56	32.47	44.00	4651
2	4662K-ND	1.19	10.29	34.07	48.16	4662
3	4671K-ND	1.15	9.56	32.47	23.28	4671
4	4672K-ND	1.01	9.56	32.47	18.02	4672
4	4673K-ND	1.01	9.56	32.47	18.02	4673

MIL-MAX

Supports de transistor

Placage :
Douille (broche) : 200 µm
Sn/Pb (conforme à RoHS) : 200 µm Sn ; Contact (pince) : 30 µm Au



Nb de broches	N° de référence Digi-Key	1	10	100	N° de référence Mil-Max
Boîtier TO-5					
3	ED2150-ND	1.09	.93	.76	917-93-103-41-005000
3	ED90273-ND	1.50	1.27	1.04	917-43-103-41-005000
4	ED2151-ND	1.18	1.00	.82	917-93-104-41-005000
4	ED90274-ND	1.58	1.35	1.10	917-43-104-41-005000
8	ED2152-ND	1.52	1.30	1.06	917-93-108-41-005000
8	ED90275-ND	1.95	1.65	1.35	917-43-108-41-005000
Boîtier TO-100					
8	ED2153-ND	1.52	1.30	1.06	917-93-208-41-005000
8	ED90276-ND	1.95	1.65	1.35	917-43-208-41-005000
10	ED2154-ND	2.24	1.90	1.55	917-93-210-41-005000
10	ED90277-ND	2.35	2.00	1.63	917-43-210-41-005000

◆ Conforme à RoHS

KEYSTONE

Supports de transistor de puissance TO-3

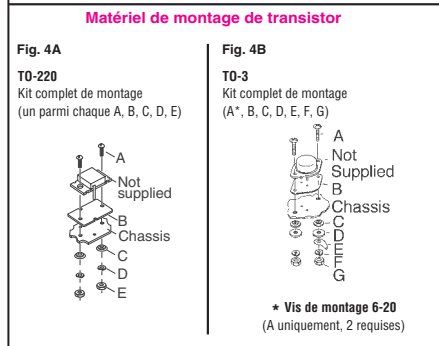
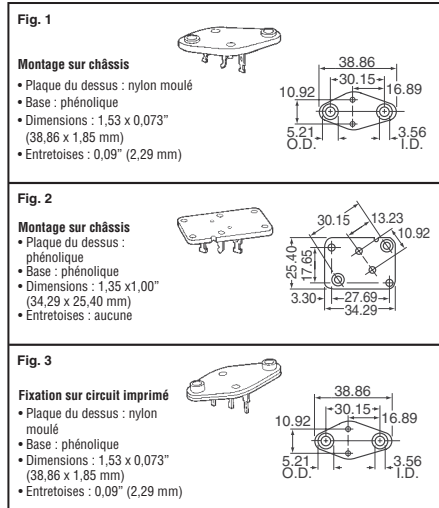


Fig.	N° de référence Digi-Key	1	10	100	N° de référence Keystone
1	4601K-ND	2.09	1.97	1.89	4601
2	4606K-ND	1.79	1.68	1.47	4606
3	4600K-ND	1.86	1.76	1.60	4600
4A	4724K-ND	1.79	1.66	1.47	4724
4B	4725K-ND	1.79	1.66	1.47	4725
4B	4706K-ND*	2.45/20	23.23/200		4706

ASAHI RUBBER INC.

Pastilles de dissipateur de chaleur

Asahi Rubber offre un produit excellent pour les applications nécessitant une solution thermique. La série ART est un gel de silicone thermiquement conducteur pouvant être coupé à la demande.

Caractéristique :
• Couleur : gris • Dimensions : 11,81 x 8,46" (300 x 215 mm) • Plaque d'épaisseurs : 0,3 à 2,0 mm • Plage de températures de fonctionnement : -60 à 200 °C

Épaisseur (pouces)	N° de référence Digi-Key	1	10	50	N° de réf. Asahi
.01 (0.3)	509-1000-ND	40.76	37.37	33.29	ART03
.02 (0.5)	509-1001-ND	44.90	41.16	36.67	ART05
.04 (1.0)	509-1002-ND	64.87	59.47	52.98	ART10
.06 (1.5)	509-1003-ND	83.17	76.24	67.92	ART15
.08 (2.0)	509-1004-ND	101.74	93.27	83.09	ART20

molex

Supports de transistor TO-220 à patte de soudure

Montage sur CI : 0,100" (2,54 mm) centre. Ces trois supports de transistor sont préassemblés et prêts à être soudés sur un circuit imprimé. Le modèle éprouvé à double porte-à-faux élimine les déformations de circuit causées par l'expansion thermique et les tolérances mécaniques.

Le mouvement linéaire des fils de transistor dans le support n'affecte pas la fiabilité du contact.

Matériau : laiton étamé, nylon 94V-2

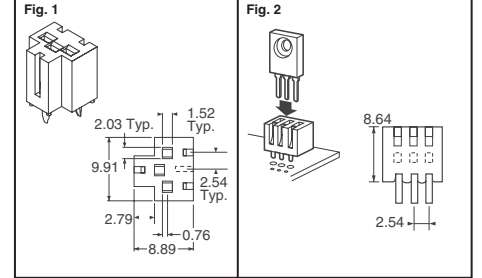


Fig.	N° de référence Digi-Key	1	10	100	N° de référence Molex
1	WM2550-ND	1.19	1.13	1.03	09-48-3031
2	WM2551-ND	1.56	1.47	1.34	10-18-2031